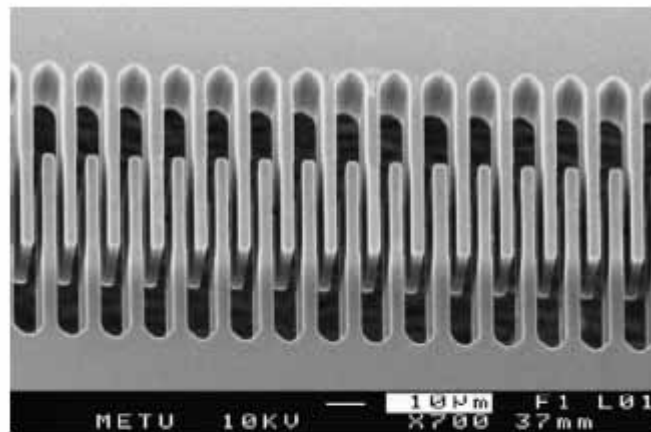
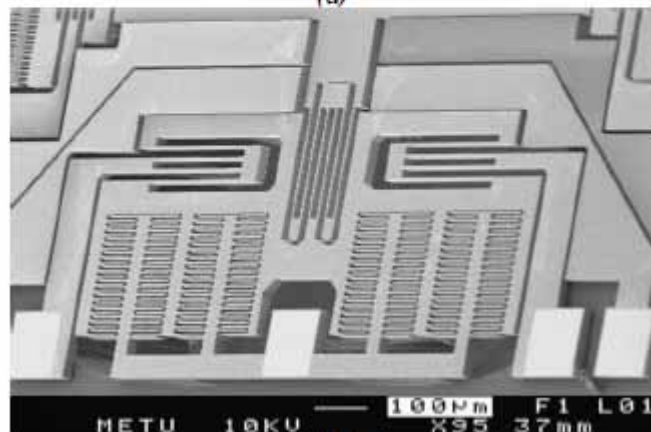


CMOSチップとハイブリッドに集積化されたジャイロスコープ

by S.E. Alper et al.



(a)



(b)

Figure 3: SEM pictures of the fabricated gyroscope, showing (a) 25 μm -thick comb fingers with 2.6 μm capacitive gap, and (b) suspended sense-electrode of the fabricated gyroscope.

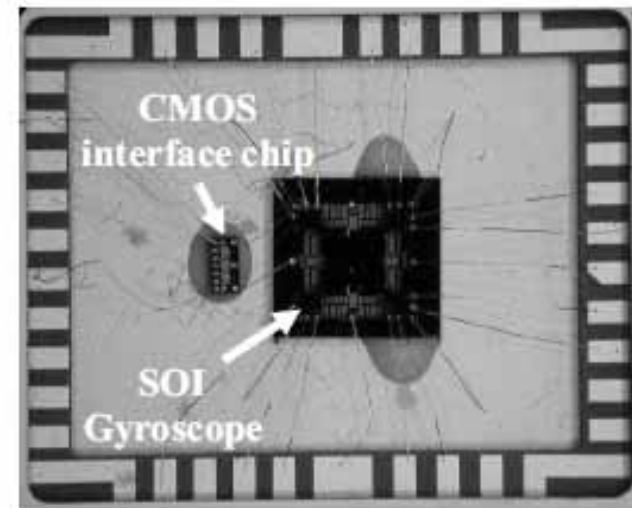


Figure 4: The fabricated gyroscope hybrid-connected to a CMOS unity-gain buffer type capacitive interface circuit.

ワイヤーボンディングにより、電氣的に接続されている。CMOSインターフェースチップは、標準的な $0.6 \mu\text{m}$ のCMOSプロセスで作製された。ジャイロスコープとインターフェースチップの大きさは、それぞれ 3×3 と $0.7 \times 1.3 \text{mm}^2$ である。